

芯片封装低温银胶

产品名称	芯片封装低温银胶
公司名称	广州市银标贸易有限公司
价格	2999.00/千克
规格参数	1:1 美国:美国
公司地址	广州市番禺区钟村街钟一村“高沙”工业区(厂房A)AS398
联系电话	13710259859 13710259859

产品详情

IC芯片封装低温银胶

987导电胶是根据ROHS指令要求设计的一种单组份导电胶，它适用于金属或其他导体材料、半导体器件的导电粘结及电子线路互联，987具有低温固化之性能，特别适合于无法实现高温（>100℃）烘烤的材料粘结。

987导电胶无需

-40℃ 冷藏，可室温（<40℃）贮藏12个月，使用简单方便。标准固化条件为[30min@80℃](#)。

E104A导电胶是款非溶剂胶，适用于印刷和点胶的方式涂胶。

UNCURED PROPERTIES 固化前主要参数

Filler /填料

Silver/银

测试方法

Viscosity/粘度@ 25 ° C (Brookfield CP-51 @ 5 rpm)

30 ~ 50 Kcp

ASTM D1084-97

Work Life/施胶时间 @25 ° C

> 100 hours

Shelf Life/保质期 @ <20 ° C

> 3 months

CURE PROCESS 固化条件

Recommended Condition/推荐固化条件

45 min @90 ° C

DSC , 10K/min

Alternate Condition /其他可选条件

60 min @ 80 ° C

*The ramp cure was observed to yield reduced voiding and increased strength.

渐进升温可以减少气泡产生，以及增加强度。

*Higher Temp. or longer curing would increase strength.

提高温度或延长时间，可充分固化。

PHYSIOCHEMICAL PROPERTIES-PSOT CURE 固化后物理化学性质

Glass Transition Temperature/玻璃转化温度Tg

113 ° C

PH / 酸碱度

5.8

Coefficient of Thermal Expansion/热膨胀系数

56 ppm/ ° C

Below Tg

Volume Conductivity/体积电阻率

< 0.0003 .cm

ASTM D257

Thermal Conductivity导热系数 @ 121 ° C

30.7 W/mK

ASTM-C518

Shear Strength/ 剪切强度 @ 25 ° C

> 18Kg/die

ASTM D412

Tensile Strength拉伸强度 @ 25 ° C

> 2800 psi